



Zur sofortigen Veröffentlichung

TUNDRA UNTERZEICHNET VEREINBARUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT MOTOROLA FÜR DIE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER POWERPC HOST BRIDGE TECHNOLOGIE

Vereinbarung richtet Tundra auf Marktführung im Bereich Embedded Systeme aus

Ottawa, Ontario – 30. September 2003 - Tundra Semiconductor (TSX:TUN), das führende Unternehmen für System Interconnect gab heute die Unterzeichnung einer Multi-Millionen Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Motorola für die Entwicklung der nächsten Generation der PowerPC® System Interconnect Technologie bekannt.

Die PowerPC Technologie basiert auf einer Hochleistungsprozessor-Busspezifikation. PowerPC Hostprozessoren werden von führenden Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, drahtlose Geräte und Speicherung für verschiedene Anwendungen eingesetzt, z.B. Internet-Router, drahtlose Basisstationen, Medien-Gateways, Speicherschalter, sowie Hochgeschwindigkeitsdrucker.

PRODUKT-ROADMAP

"Diese Vereinbarung festigt unsere Geschäftsbeziehungen mit Motorola – Marktführer für Embedded Systeme – und stärkt unsere Strategie für PowerPCs", sagte Jim Roche, Vorsitzender und Generaldirektor von Tundra. "Mit der Entwicklung dieser neuen Gerätegeneration treibt Tundra die Produktfamilie der PowerPC Host Bridges weiter voran. Diese Vereinbarung stellt für unsere Kunden eine vollständige Roadmap für PowerPC System Interconnect an.

"Viele Industrieunternehmen nehmen für die erforderlichen System Interconnect Anforderungen die Dienste von Outsourcing-Unternehmen wahr, um sich intensiver um eigene Wettbewerbsvorteile kümmern zu können", sagte Jim Roche. "Während dieser Trend immer weiter auf dem Vormarsch ist, nimmt Tundra die Rolle des Marktführers für standardbasierte System Interconnect Produkte auf Outsourcing Basis ein."

RELATED NEWS

Tundra gab in Related News den Kauf der Motorola PowerPC Host Bridge Produktlinie (MPC106 und MPC107) zu einem Kaufpreis von \$20 Millionen USD bekannt. Weitere Informationen finden Sie auf der Tundra Homepage www.tundra.com.

Über Tundra

Die Tundra Semiconductor Corporation (TSX:TUN) designt, entwickelt und vermarktet System Interconnect für weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kommunikations- und Speichersystemtechnologie. Tundra System Interconnect ist eine lebendige Kommunikationstechnologie, die es dem Anwender erlaubt, kritische Systemkomponenten miteinander zu verbinden, bei gleichzeitiger Verkürzung von Entwicklungszyklen und Leistungsoptimierung. Die Applikationen beinhalten eine kabellose Infrastruktur, Speicher-Networking, Network-Zugang, militärische Anwendungen und industrielle Automatisierung. Tundra hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Ontario, Kanada und Niederlassungen in South Portland, Maine und ein europäisches Vertriebsbüro mit Sitz in Maidenhead, Großbritannien. Tundra vertreibt seine Produkte weltweit mit Hilfe eines Netzwerks von Direktvertriebsmitarbeitern, unabhängigen Distributoren und Repräsentanten der Hersteller. Tundra beschäftigt weltweit ca. 200 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.tundra.com.

###

Tundra System Interconnect ... Silicon Behind the Network™

TUNDRA is a registered trademark of Tundra Semiconductor Corporation (Canada, U.S.A. and U.K.). *TUNDRA*, the Tundra logo, PowerSpan II and Silicon Behind the Network are trademarks of Tundra Semiconductor Corporation. Other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

©Copyright 2003 Tundra Semiconductor Corporation. All rights reserved. Information subject to change without notice.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Stacey Diffin-Lafleur, Tundra Semiconductor Corp.,
1.613.592.0714 Durchwahl 1820
stacey.diffin-lafleur@tundra.com

Kenneth McGillvary, TKO Marketing Consultants
+44 1444 473 555 kenneth@tko.co.uk